

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ogólnie znana magistrala szyn nośnych do modularnego systemu obudów elektronicznych.**

Przy zasilaniu, łączeniu i dystrybucji w zastosowaniach modularnych magistrala szyn nośnych zastępuje kosztowne okablowanie jednostkowe dzięki bezprzerwowemu i elastycznemu rozwiązaniu systemowemu.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm. Dzięki metodzie rozplwywu można w pełni automatycznie obrabiać blok stykowy magistrali SMD przy produkcji podzespołu. Odporne, pozłacane powierzchnie styków gwarantują trwale niezawodne kontaktowanie dla wszystkich szerokości obudowy.

- **Nieograniczone możliwości skalowania.** - ogólne rozwiązanie łączące, dotyczące wszystkich szerokości systemów - od tarczy 6 mm do wieloprzestrzennej obudowy 67 mm
- **Instalacja łatwa w serwisowaniu.** - prosta wymiana modułów, również tych w istniejących związkach modułowych bez wpływu na moduły sąsiadujące
- **Uniwersalna integracja** - magistrala systemowa: bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm
- **Maksymalne możliwości dysponowania.** - Pięć całkowicie galwanizowanych i częściowo złożonych bliźniaczych styków łukowych zapewnia trwały kontakt z magistralą szyn nośnych Kołnierze lutownicze THR [roplwyw

przewlekany] zapewniają stabilne połączenie z płytką obwodu drukowanego.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, pozłacany, czarny
Nr zam.	1155890000
Typ	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX
GTIN (EAN)	4032248942527
Ilość	78 Szt.
parametry produktu	UL: 300 V / 5 A
opakowanie	skrzynia

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	5,9 mm	Wysokość (cale)	0,232 inch
Szerokość	16,3 mm	Szerokość (cale)	0,642 inch
Długość	24 mm	Długość (cale)	0,945 inch
Masa netto	2,782 g		


Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	$175 \leq CTI < 400$	Wytrzymałość izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
Moisture Level (MSL)	1	Powierzchnia styku	połączany
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura magazynowania, max.	70 °C
Temperatura pracy, min.	-50 °C	Temperatura pracy, max.	100 °C
Zakres temperatur montaż, min.	-30 °C	Zakres temperatur montaż, max.	100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą	IEC 60664-1, IEC 61984	napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3	63 V
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/3	1,5 kV	Odstęp izolacyjny po izolacji, min.	3,2 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.	2,3 mm		

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus)		Nr certyfikatu (cURus)	E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)	300 V	Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)	50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)	50 V	Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)	5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)	5 A	Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)	5 A
Odniesienie do wartości znamionowych	W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.		

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	$175 \leq CTI < 400$
grupa materiałów izolacyjnych	IIIa		

Dane ogólne

Barwny	czarny	Stopień ochrony	IP20
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011		

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-18-27-92

Ważna informacja

Zgodność IPC

Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E60693

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

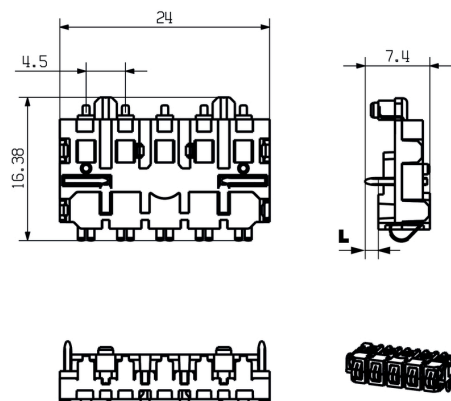
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

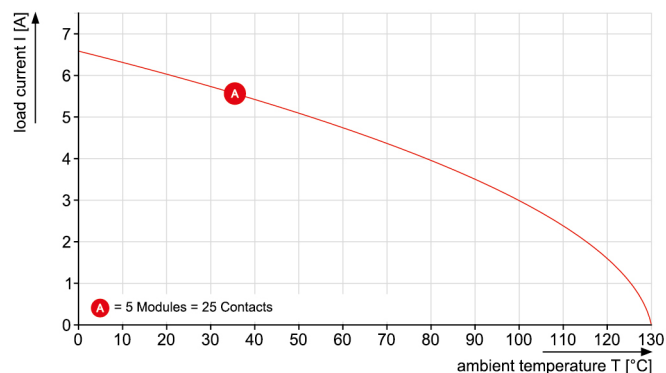
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CH20M22-Bus



SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Profil wkładki Bus - TS35x7,5

**Ogólnie znana magistrala szyn nośnych do modularnego systemu obudów elektronicznych.**

Przy zasilaniu, łączeniu i dystrybucji w zastosowaniach modularnych magistrala szyn nośnych zastępuje kosztowne okablowanie jednostkowe dzięki bezprzerwowemu i elastycznemu rozwiązaniu systemowemu.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm. Dzięki metodzie rozplwy można w pełni automatycznie obrabiać blok stykowy magistrali SMD przy produkcji podzespołu. Odporne, połączane powierzchnie styków gwarantują trwale niezawodne kontaktowanie dla wszystkich szerokości obudowy.

- **Nieograniczone możliwości skalowania.** - ogólne rozwiązanie łączące, dotyczące wszystkich szerokości systemów - od tarczy 6 mm do wieloprzestrzennej obudowy 67 mm

- **Instalacja łatwa w serwisowaniu.** - prosta wymiana modułów, również tych w istniejących związkach modułowych bez wpływu na moduły sąsiadujące

- **Uniwersalna integracja** - magistrala systemowa: bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm

- **Maksymalne możliwości dysponowania.** - Pięć całkowicie galwanizowanych i częściowo złożonych bliźniaczych styków łukowych zapewnia trwały kontakt z magistralą szyn nośnych Kołnierze lutownicze THR [roplwy przewlekany] zapewniają stabilne połączenie z płytką obwodu drukowanego.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Wersja
Nr zam.	1248170000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 750 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053272	25.1 mm
Ilość	5 Szt.	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Wersja
Nr zam.	1248150000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 250 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053296	25.1 mm
Ilość	10 Szt.	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Wersja
Nr zam.	1248160000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 500 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053289	25.1 mm
Ilość	10 Szt.	

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

CH20M BUS -AP - płytki końcowe profilu wkładki Bus

**Ogólnie znana magistrala szyn nośnych do modularnego systemu obudów elektronicznych.**

Przy zasilaniu, łączeniu i dystrybucji w zastosowaniach modularnych magistrala szyn nośnych zastępuje kosztowne okablowanie jednostkowe dzięki bezprzerwowemu i elastycznemu rozwiązaniu systemowemu.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm. Dzięki metodzie rozplwy można w pełni automatycznie obrabiać blok stykowy magistrali SMD przy produkcji podzespołu. Odporne, pozłacane powierzchnie styków gwarantują trwale niezawodne kontaktowanie dla wszystkich szerokości obudowy.

- **Nieograniczone możliwości skalowania.** - ogólne rozwiązanie łączące, dotyczące wszystkich szerokości systemów - od tarczy 6 mm do wieloprzestrzennej obudowy 67 mm

- **Instalacja łatwa w serwisowaniu.** - prosta wymiana modułów, również tych w istniejących związkach modułowych bez wpływu na moduły sąsiadujące

- **Uniwersalna integracja** - magistrala systemowa: bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm

- **Maksymalne możliwości dysponowania.** - Pięć całkowicie galwanizowanych i częściowo złożonych bliźniaczych styków łukowych zapewnia trwały kontakt z magistralą szyn nośnych Kołnierze lutownicze THR [roplwy przewlekany] zapewniają stabilne połączenie z płytką obwodu drukowanego.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS-AP RE TS 35X7 ...	Wersja
Nr zam.	1193170000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 40.5 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4032248987924	5.1 mm
Ilość	50 Szt.	
Typ	CH20M BUS-AP LI TS 35X7 ...	Wersja
Nr zam.	1193160000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 40.5 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4032248987771	5.1 mm
Ilość	50 Szt.	

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

CH20M BUS - płytki drukowane magistral bus

**Ogólnie znana magistrala szyn nośnych do modularnego systemu obudów elektronicznych.**

Przy zasilaniu, łączeniu i dystrybucji w zastosowaniach modularnych magistrala szyn nośnych zastępuje kosztowne okablowanie jednostkowe dzięki bezprzerwowemu i elastycznemu rozwiązaniu systemowemu.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm. Dzięki metodzie rozplwy można w pełni automatycznie obrabiać blok stykowy magistrali SMD przy produkcji podzespołu. Odporne, pozłacane powierzchnie styków gwarantują trwale niezawodne kontaktowanie dla wszystkich szerokości obudowy.

- **Nieograniczone możliwości skalowania.** - ogólne rozwiązanie łączące, dotyczące wszystkich szerokości systemów - od tarczy 6 mm do wieloprzestrzennej obudowy 67 mm

- **Instalacja łatwa w serwisowaniu.** - prosta wymiana modułów, również tych w istniejących związkach modułowych bez wpływu na moduły sąsiadujące

- **Uniwersalna integracja** - magistrala systemowa: bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm

- **Maksymalne możliwości dysponowania.** - Pięć całkowicie galwanizowanych i częściowo złożonych bliźniaczych styków łukowych zapewnia trwały kontakt z magistralą szyn nośnych Kołnierze lutownicze THR [roplwy przewlekany] zapewniają stabilne połączenie z płytką obwodu drukowanego.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/500	Wersja
Nr zam.	1248230000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118053227	
Ilość	10 Szt.	
Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/250	Wersja
Nr zam.	1248220000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 250 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053234	21.8 mm
Ilość	10 Szt.	
Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/750	Wersja
Nr zam.	1248240000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118053210	
Ilość	5 Szt.	

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

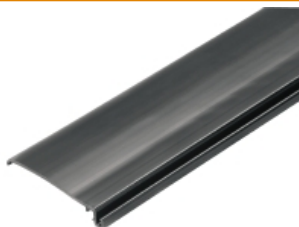
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

CH20M BUS-ADP - pokrywa profilu wkładki Bus

**Ogólnie znana magistrala szyn nośnych do modularnego systemu obudów elektronicznych.**

Przy zasilaniu, łączeniu i dystrybucji w zastosowaniach modularnych magistrala szyn nośnych zastępuje kosztowne okablowanie jednostkowe dzięki bezprzerwowemu i elastycznemu rozwiązaniu systemowemu.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm. Dzięki metodzie rozplwy można w pełni automatycznie obrabiać blok stykowy magistrali SMD przy produkcji podzespołu. Odporne, połączane powierzchnie styków gwarantują trwale niezawodne kontaktowanie dla wszystkich szerokości obudowy.

- **Nieograniczone możliwości skalowania.** - ogólne rozwiązanie łączące, dotyczące wszystkich szerokości systemów - od tarczy 6 mm do wieloprzestrzennej obudowy 67 mm

- **Instalacja łatwa w serwisowaniu.** - prosta wymiana modułów, również tych w istniejących związkach modułowych bez wpływu na moduły sąsiadujące

- **Uniwersalna integracja** - magistrala systemowa: bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm

- **Maksymalne możliwości dysponowania.** - Pięć całkowicie galwanizowanych i częściowo złożonych bliźniaczych styków łukowych zapewnia trwały kontakt z magistralą szyn nośnych Kołnierze lutownicze THR [roplwy przewlekany] zapewniają stabilne połączenie z płytką obwodu drukowanego.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS-ADP TS 35/500	Wersja
Nr zam.	1248260000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 500 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118052992	39.5 mm
Ilość	10 Szt.	
Typ	CH20M BUS-ADP TS 35/250	Wersja
Nr zam.	1248250000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 250 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053203	39.5 mm
Ilość	10 Szt.	
Typ	CH20M BUS-ADP TS 35/750	Wersja
Nr zam.	1248270000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 750 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118052985	39.5 mm
Ilość	5 Szt.	

SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Profil wkładki Bus - TS35x15

**Ogólnie znana magistrala szyn nośnych do modularnego systemu obudów elektronicznych.**

Przy zasilaniu, łączeniu i dystrybucji w zastosowaniach modularnych magistrala szyn nośnych zastępuje kosztowne okablowanie jednostkowe dzięki bezprzerwowemu i elastycznemu rozwiązaniu systemowemu.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm. Dzięki metodzie rozplwy można w pełni automatycznie obrabiać blok stykowy magistrali SMD przy produkcji podzespołu. Odporne, pozłacane powierzchnie styków gwarantują trwale niezawodne kontaktowanie dla wszystkich szerokości obudowy.

- **Nieograniczone możliwości skalowania.** - ogólne rozwiązanie łączące, dotyczące wszystkich szerokości systemów - od tarczy 6 mm do wieloprzestrzennej obudowy 67 mm

- **Instalacja łatwa w serwisowaniu.** - prosta wymiana modułów, również tych w istniejących związkach modułowych bez wpływu na moduły sąsiadujące

- **Uniwersalna integracja** - magistrala systemowa: bezpiecznie zintegrowana w standardowej szynie nośnej 35 mm

- **Maksymalne możliwości dysponowania.** - Pięć całkowicie galwanizowanych i częściowo złożonych bliźniaczych styków łukowych zapewnia trwały kontakt z magistralą szyn nośnych Kołnierze lutownicze THR [roplwy przewlekany] zapewniają stabilne połączenie z płytką obwodu drukowanego.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Wersja
Nr zam.	1248190000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 500 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053258	25.1 mm
Ilość	5 Szt.	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Wersja
Nr zam.	1248180000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 250 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053265	25.1 mm
Ilość	5 Szt.	
Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X ...	Wersja
Nr zam.	1248210000	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 750 mm, Szerokość:
GTIN (EAN)	4050118053241	25.1 mm
Ilość	5 Szt.	

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

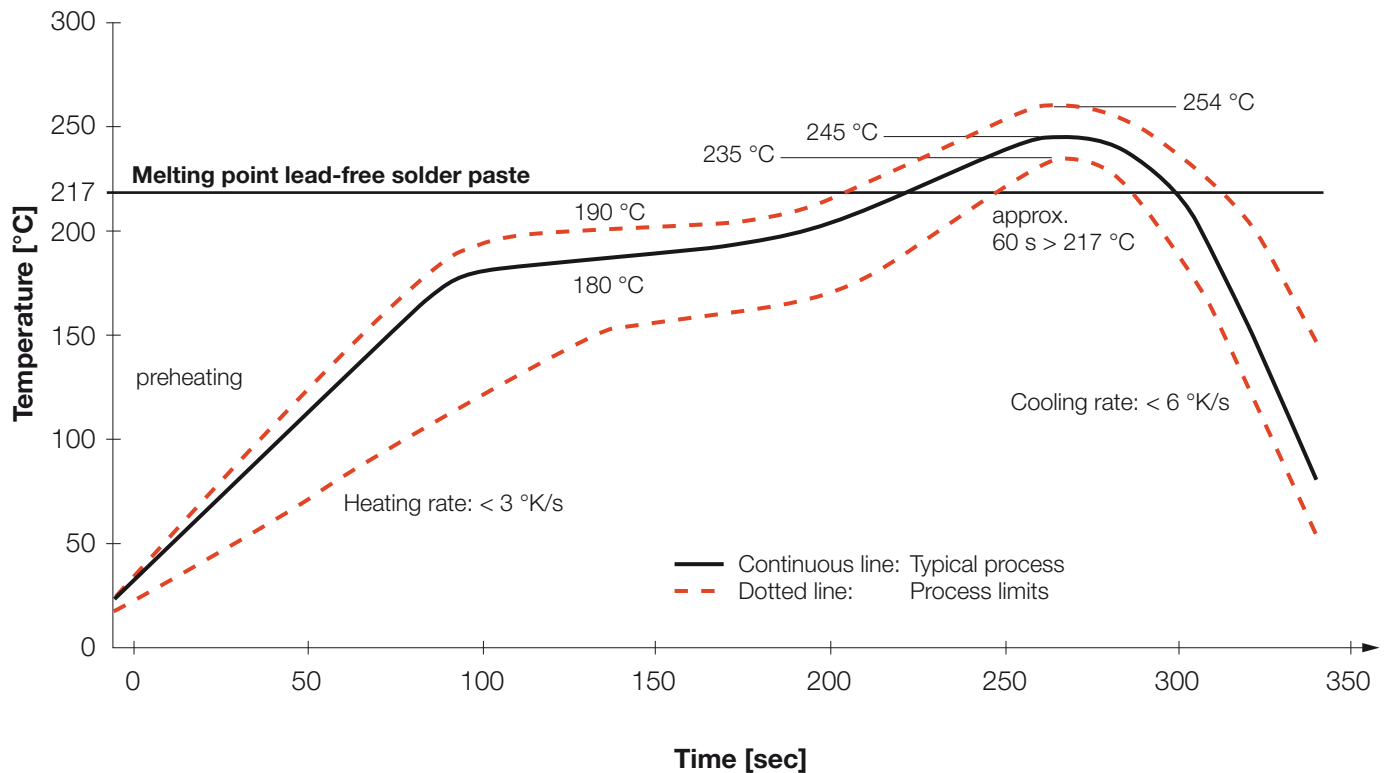
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.